

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成26年10月23日 (2014.10.23)

【公表番号】特表2014-500335(P2014-500335A)

【公表日】平成26年1月9日 (2014.1.9)

【年通号数】公開・登録公報2014-001

【出願番号】特願2013-531673(P2013-531673)

【国際特許分類】

C 0 8 L 23/06 (2006.01)

C 0 8 J 3/20 (2006.01)

H 0 1 B 9/00 (2006.01)

H 0 1 B 7/02 (2006.01)

H 0 1 B 3/44 (2006.01)

H 0 1 B 3/30 (2006.01)

B 2 9 C 47/02 (2006.01)

B 2 9 K 23/00 (2006.01)

B 2 9 L 9/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 23/06

C 0 8 J 3/20 C E S Z

H 0 1 B 9/00 A

H 0 1 B 7/02 Z

H 0 1 B 3/44 F

H 0 1 B 3/30 P

B 2 9 C 47/02

B 2 9 K 23:00

B 2 9 L 9:00

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月4日 (2014.9.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

低密度ポリエチレン (L D P E) 及び少量の高密度ポリエチレン (H D P E) を含むポリマー組成物を、少なくとも H D P E の融解温度まで加熱することと、

0 . 1 / m i n から 2 0 / m i n までの冷却速度で、加熱されたポリマー組成物を制御冷却することと、

ポリマー組成物を形成することと

を含む方法。

【請求項 2】

A C 絶縁破壊強度が、A S T M D 1 4 9 に従って 8 5 マイクロメートルの薄膜上で測定して、1 7 0 k V / m m 超であるポリマー組成物を形成することを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

低密度ポリエチレン (L D P E) 及び少量の高密度ポリエチレン (H D P E) を含むポ

リマー組成物をHDPEの融解温度を超える温度まで加熱することと、
伝導体上に加熱されたポリマー組成物を押出すことと、
0.1 / min から 20 / min の間の冷却速度で伝導体上に位置付けられた加熱されたポリマー組成物を制御冷却することと、
伝導体上に、ポリマー組成物を含む被覆膜を形成することと
を含む、被覆伝導体を製造する方法。

【請求項 4】

伝導体と、
伝導体上の被覆膜であって、大部分の量の低密度ポリエチレン(LDPE)の中に分散した少量の高密度ポリエチレン(HDPE)のラメラを含むポリマー組成物を含む被覆膜と
を含む、被覆伝導体。

【請求項 5】

ポリマー組成物が、ASTM D 149 に従って 85 マイクロメートルの薄膜上で測定して、170 kV/mm 超の AC 絶縁破壊強度を有する、請求項 4 に記載の被覆伝導体
。